

# CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

## Disclaimer

---

본 자료는 주식회사 저스템(이하 “회사”)의 재정 상황, 운영·영업성과 및 회사 경영진의 계획·목표와 관련된 향후 전망을 포함하고 있습니다. 그러한 향후 전망은 회사의 실제 성과에 영향을 줄 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성, 그리고 다른 요인들에 의해 변경될 수 있습니다.

회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적 또는 명시적으로 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다.

따라서, 본 자료는 투자자들의 투자 결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대해 어떠한 책임이나 손해 또는 피해를 지지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 작성일 현재 시점의 정보에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 현행화 할 책임이 없습니다.

**CREATIVE & INNOVATION**  
GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

INVESTOR RELATIONS 2025

# TABLE OF CONTENTS

Ch.01\_ Business Overview

Ch.02\_ Company Overview

Appendix



# 저시스템은 기술 중심 기반의 반도체 오염제어 솔루션 Global No.1 기업입니다.

## IT & Energy 솔루션 Provider

### 기술 선도 기업

#### 업계 최고의 솔루션 보유

##### 반도체 습도제어 솔루션 Global No.1

- 국내외 IDM업체 점유율 1위
- 세계최초 기류제어 시스템 개발(JFS)
- N2 LPM System 110여종 개발

##### 업계 최고의 R&D 역량

- 특허 수 310건 확보
- 첨단산업 노하우를 보유한 연구진 보유
- 대한민국 최우수 기업 연구소 선정(K-HERO)
- 장영실상 수상

### 성장산업 주요 고객사 확보

#### 글로벌 Top-tier 고객사 확보

##### 반도체

SAMSUNG

SK 하이닉스

micron

HPSP  
High Pressure Solution Provider

##### 디스플레이 / 2차전지 / 태양광

LG 디스플레이

SAMSUNG DISPLAY

CSOT

Visionox

Hanwha

LG전자

### 다각화된 사업 포트폴리오 구축

#### 독보적 기술 기반 성장동력 확보

##### 핵심 공정 기술 기반 첨단 산업 모든 분야 대응 가능

반도체

디스플레이

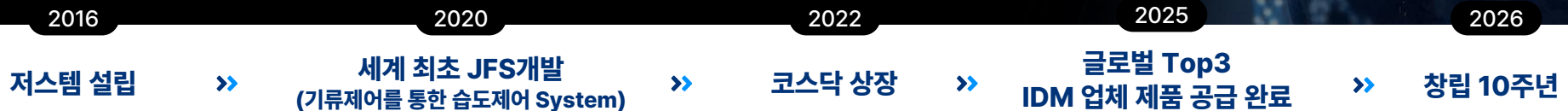
태양광

2차전지



## 저시스템이 걸어온 길

저시스템은 창립 이래 기술 혁신과 선제적 투자를 통해  
**글로벌 기업으로 도약**하고 있습니다.



### Phase 1

창조적  
기술력 확보

- 반도체 습도제어 장비 개발
- 디스플레이, 태양광, 2차전지 장비 개발
- 글로벌 반도체 고객사 확보

### Phase 2

내부 역량 강화 &  
적극적인 기술 투자

- 선제적 투자 확대를 통한 성장 가속화
- 핵심 기술의 응용 확장
- 고객 포트폴리오의 질적 성장

### Phase 3

신성장 동력 확보 &  
지속 성장 기업 도약

- 사업 포트폴리오의 성공적 다변화
- 반도체 HBM 및 유리기판 장비 개발
- 첨단산업 솔루션 제공 기업으로 포지셔닝

저시스템의 새로운 도약 기회

## 환경 변화, 우리에게 찾아온 기회

### 시장의 변화

Market Shift

AI에 최적화된  
새로운 반도체 생태계 구축

- AI 추론 영역 확대 (Token 증가)
- HBM 수요의 폭발적 증가

### 기술의 변화

Technology

AI 확산과 고성능화로  
선단공정 기술의 중요성 부각

- 글로벌 메모리 업체들의 선단공정 전환 가속화
- 미세공정, 수율 개선을 위한 장비 투자 확대

### 공급망의 변화

Supply Chain

기술 패권을 위한  
핵심 전략 자원으로 지정학적 재편

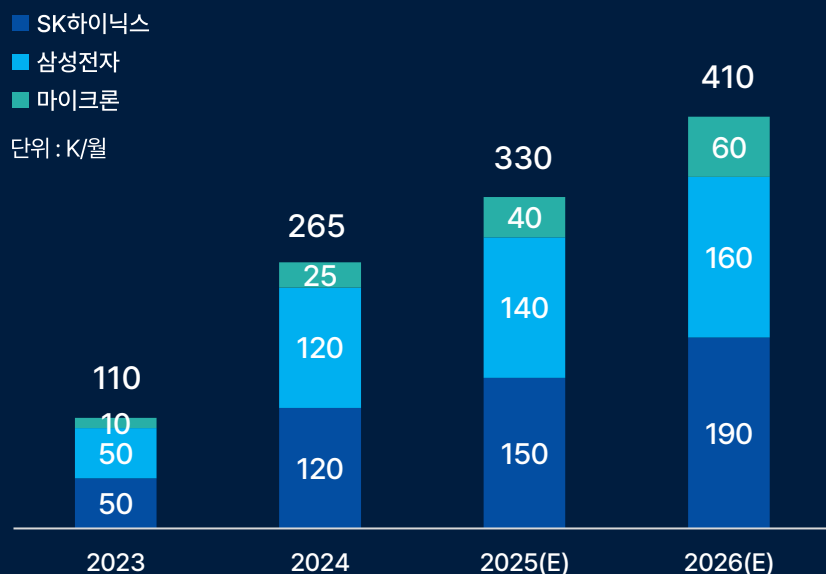
- 글로벌 팹 건설 경쟁 심화 (양적 성장)
- AI, HBM 등 첨단 기술 투자 (질적 성장)



AI 산업의 글로벌 시장 환경 변화는  
저시스템의 오랜 준비와 노력 속에서 찾아온 새로운 성장 기회

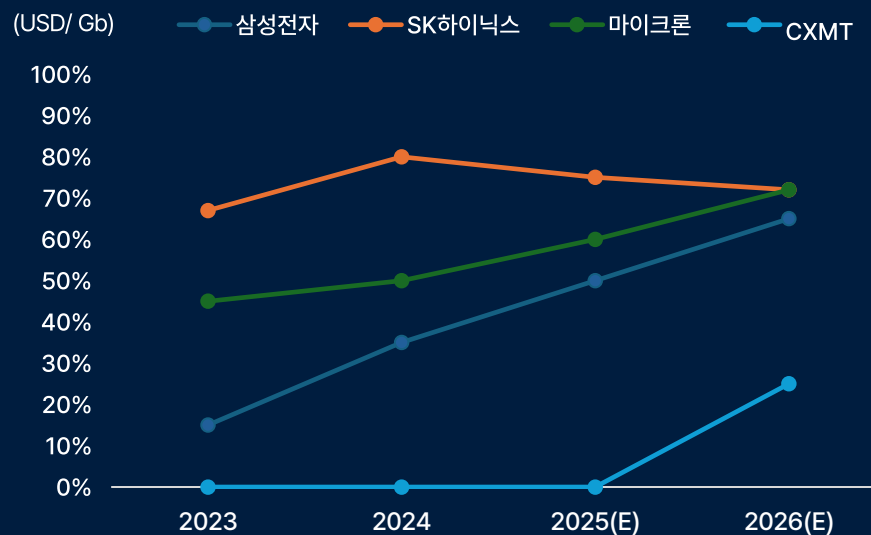
# HBM 시장 폭발적 성장과 함께 수율 개선을 위한 선단공정 인프라 투자 가속화

글로벌 IDM 3사 HBM CAPA 전망



\* Source : Trend Force

글로벌 IDM 3사 HBM 수율 개선 현황



\* Source : 증권사 리서치센터

## 글로벌 IDM 3사 HBM 수요 급증 구간 재진입

- 급증하는 AI 수요에 대응하기 위해 Capacity의 절대적 증가 필수
- 대규모 FAB 증설 및 HBM 라인 확장으로 선단공정 인프라 투자 수요 가속

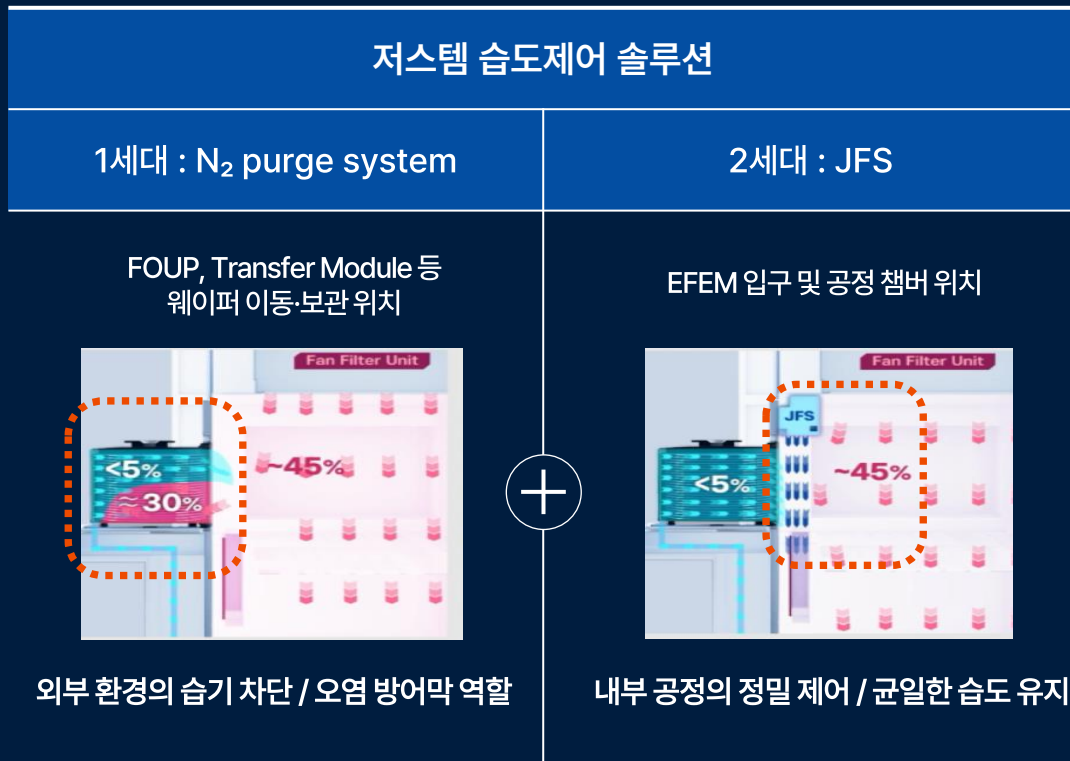
## HBM 수율 개선에 따른 선행 투자 집중 예상

- HBM 미세공정 수율이 빠르게 개선되며 생산 효율성 극대화 단계 진입
- 주요 IDM들은 생산성 극대화를 위해 공정 내 수율 개선 장비 채택 확대



## 저시스템의 습도제어 솔루션

# 1세대·2세대 솔루션의 시너지로 초저습 공정·수율 혁신 실현



외부 차단과 내부 제어의 완벽한 시너지로 초저습 공정·수율 혁신 실현

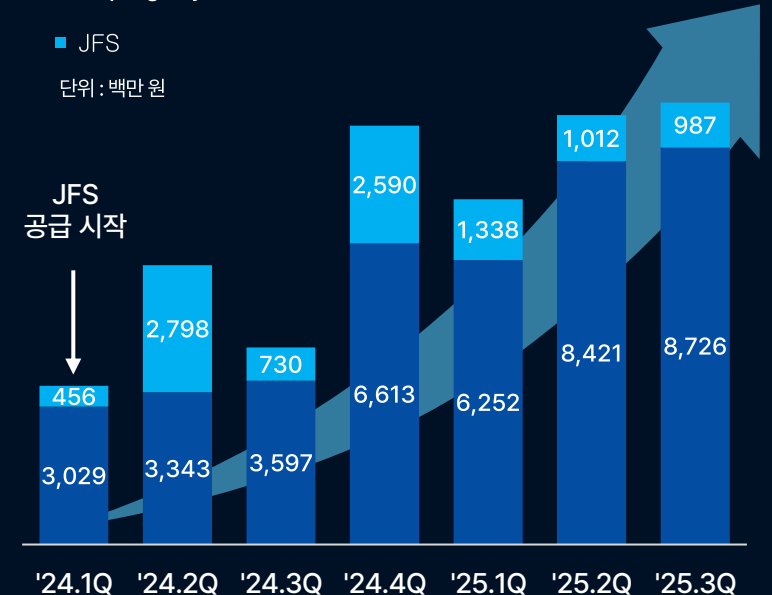
## 습도제어 솔루션(1, 2세대) 매출 추이

1세대·2세대 제품이 상호보완적으로 공급되며,  
전체 습도제어 솔루션 매출 동반 확대

■ N<sub>2</sub> purge system

■ JFS

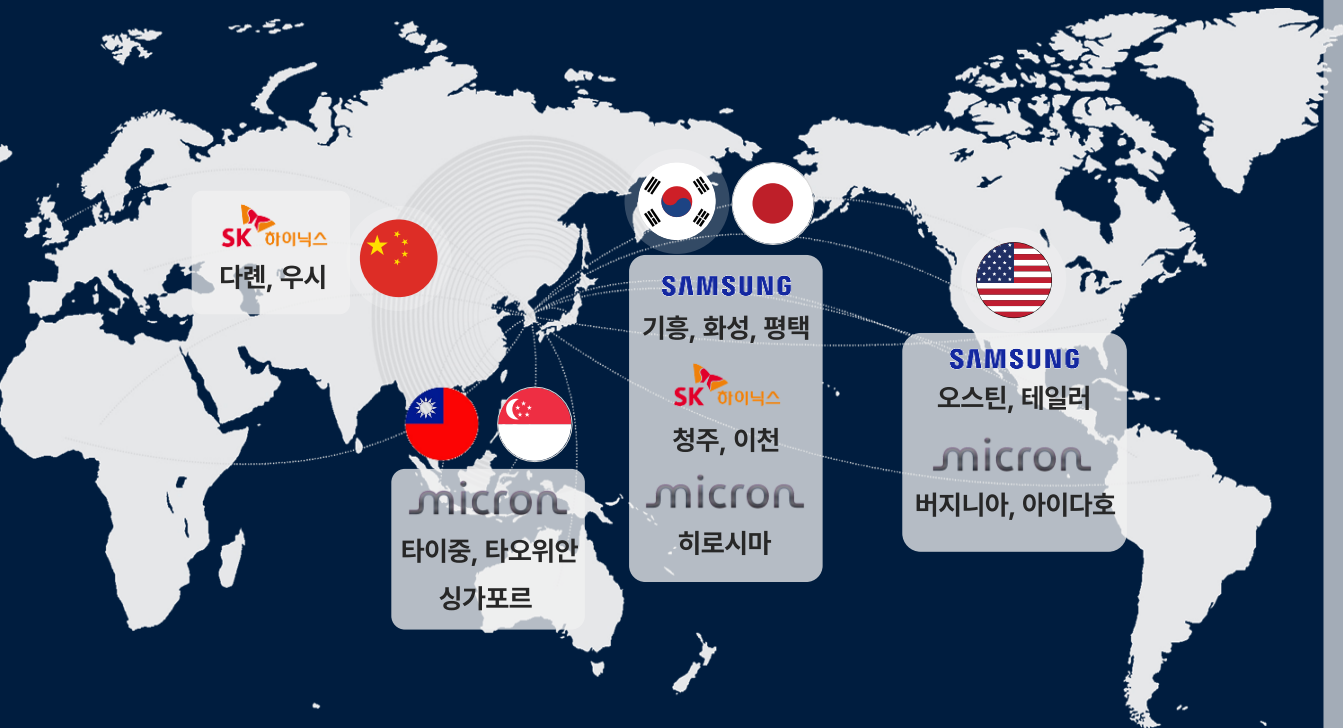
단위 : 백만 원



## 글로벌 IDM 고객 현황 및 확장 계획

# 글로벌 IDM 3사 DRAM·HBM 라인 내 안정적 공급망 구축

### 글로벌 주요 IDM 3사향 저시스템 공급 FAB 현황



글로벌 IDM사의 차세대 DRAM · HBM 라인에  
핵심 공정 장비 · 솔루션 공급 영역 확대

### 글로벌 IDM 3사 투자 확대 현황

**SAMSUNG**

**2026 테일러 공장 본격 가동**

미국 테일러 2공장 가동 및  
평택 P5 증설

**SK 하이닉스**

**2026 HBM 공급계약 확정으로  
CAPEX 30% 증액**

청주 M15X 공장 가동 및  
용인 반도체 클러스터 증설

**micron**

**2026 지속적 공급 부족  
심화 전망**

미국 보이시, 뉴욕 및  
싱가포르 HBM 라인 신규 증설

글로벌 IDM사의 본격적인 신규 투자 확대에 따른  
**폭발적 수주 기회 창출**

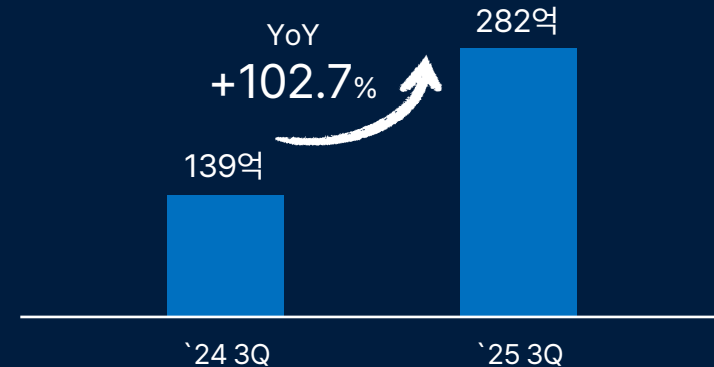
## 25.3Q REVIEW

### 글로벌 선단공정 투자 사이클 수혜로 반도체 부문 성장 본격화

#### 25.3Q 실적(종합)



#### 25.3Q 실적(반도체 부문)



#### 25.3Q 주요 요인

글로벌 IDM사의 HBM 공정 확대와  
수율 향상을 위한 수율 제어 장비  
투자 본격화로 반도체 부문 매출 급증

주요 고객사인 M사의 적극적인  
설비 투자 확대로 M사향 매출 증가

신사업 부문(태양광, 디스플레이 등)  
신규 수주 및 매출 확대

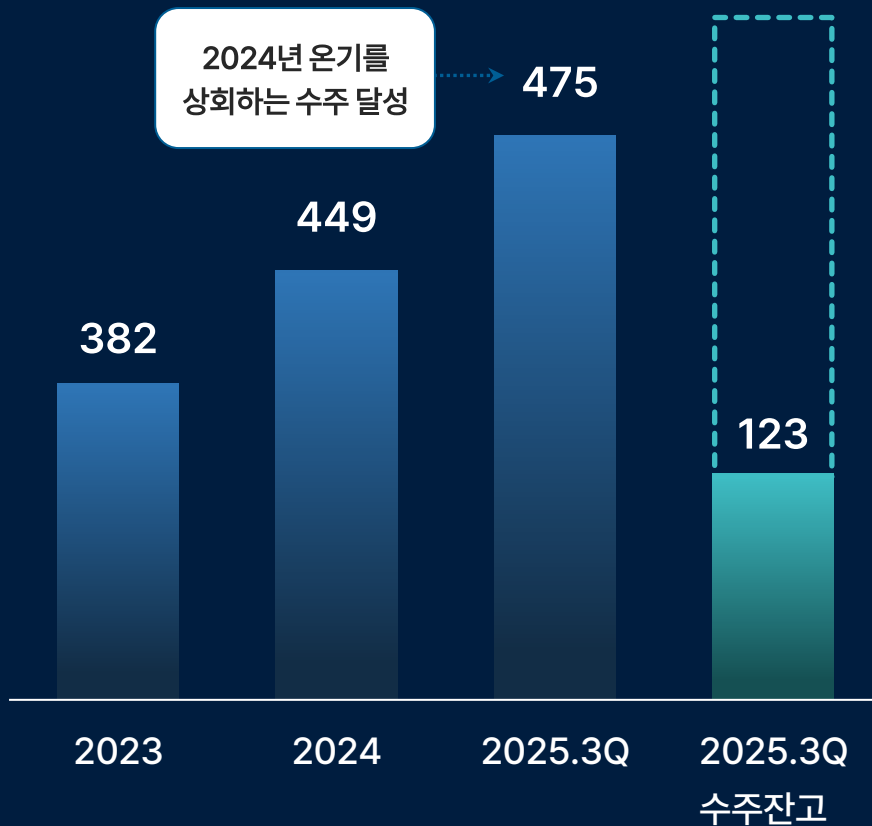


## 25.3Q 기준 수주현황

# 양산 공급 본격화와 신규 라인 진입으로 수주 고도화 및 성장 모멘텀 강화

## 2025.3Q 수주현황 및 잔고

단위: 억 원



### 반도체 부문

- 글로벌 IDM사향 1세대 N2 LPM·2세대 JFS 양산 공급 확정
- 일본 파운드리 기업의 양산 Fab 공급 확정
- 미국 테일러 프로젝트 적용 관련 JFS 평가 진행
- M사 아이다호 및 보이지 Fab 내 JFS 도입 평가 진행 중
- 기존 장비와 호환 가능한 3세대 JDM 솔루션 관련 M사와 양산성 검증 단계 진입

### 디스플레이 부문

- OLED용 고진공제전장치(VEES) S사 평가 마무리 단계로 후속 라인 횡전개 기대
- 중화권 T사 등 신규 고객사 확보로 고객 확장 중
- 중진공 제전 장치 개발 완료, 국내 S사 및 중화권 주요 패널사 대상 평가 개시
- 장비 예방 보전을 위한 이온 Sensor 개발 후 검증 완료, 본격적인 사업화 단계 진입

# CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



## 01

Investor Relations 2025

### Business Overview

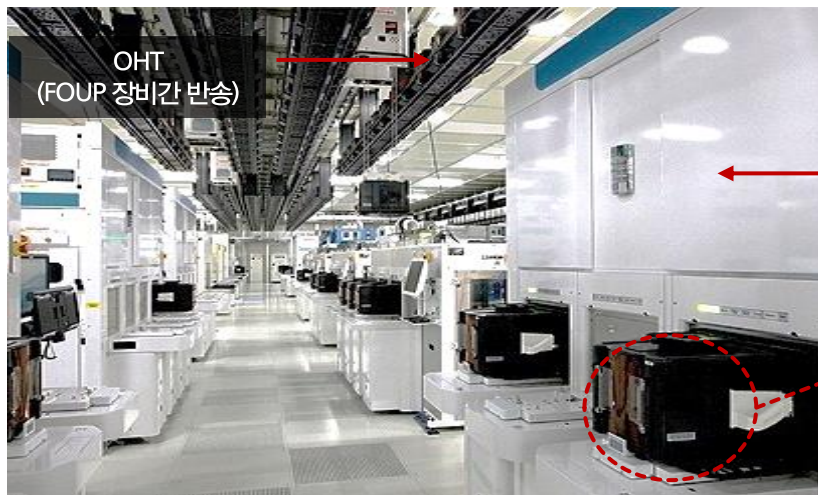
- 01. 반도체 공정 내 습도 제어의 중요성
- 02. 반도체 시장 내 수율 개선 핵심 플레이어,  
저스템 (1), (2)
- 03. 습도 제어 솔루션 포트폴리오
- 04. 반도체 수율 개선 시스템 고도화 (1), (2)
- 05. 디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축
- 06. 태양광 산업 진출 본격화

## 반도체 공정 내 습도 제어의 중요성

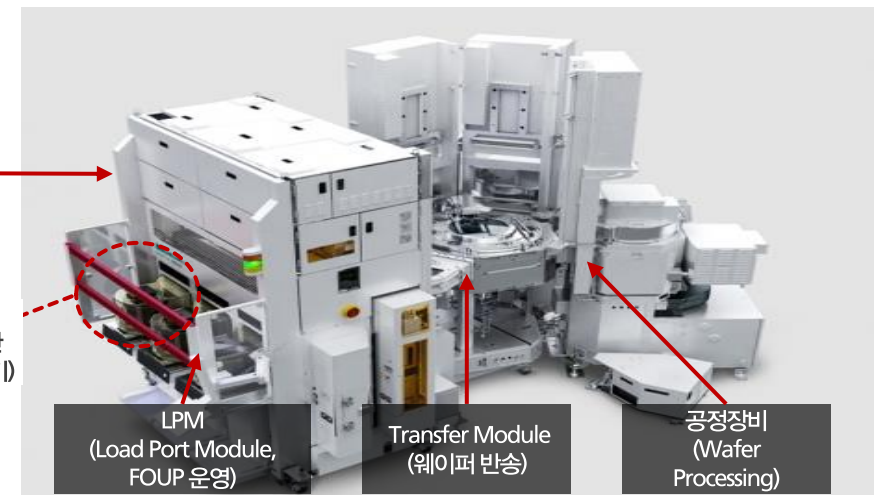
반도체 전공정 전반에서 수율에 직접적인 영향을 미치는 습도 제어에 대한 중요성 증가

반도체 전공정 미세화에 따른  
기존 Clean Class 1 환경의 한계 도달공정간 오염 물질 및 수분 발생으로  
생산 수율 감소 문제 발생반도체 전공정 습도관리 솔루션  
중요성 부각

반도체 공정 Fab. : FOUP을 통해 공정간 웨이퍼 이송

EFEM  
(웨이퍼  
반송 장비)FOUP  
(반도체 공정간  
웨이퍼 이동 용기)

반도체 공정 장비 : 웨이퍼 이송 → 오염원이 없는 청정 상태 유지 필수

웨이퍼를 외부 오염 및 습도로부터 보호 및 보관하는 용기  
공정간 이송 시 사용되어 수율에 직접적인 영향

반도체 Clean Class 1 한계 도달

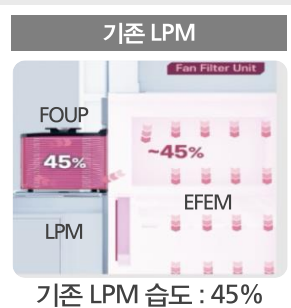
Class 1  
(0.5 $\mu$ m 이상,  
 $\leq 1\text{ea}/\text{ft}^3$ )습도  
40%~50%온도  
23~25°C



## 반도체 시장 내 수율 개선 핵심 플레이어, 저스템 (1)

최적의 습도 제어 솔루션 개발을 통한 수율 개선 Unmet Needs 해결

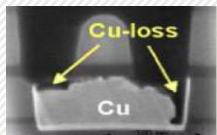
## 기존 LPM 습도 제어의 한계 발생



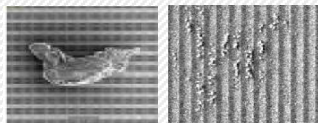
- 공정 미세화에 따른 기존 LPM의 45% 습도 유지 한계 발생
- 반도체 수율에 악영향을 미치는 고습도 환경 조성



## 미세화된 공정 내 습도로 인한 소자 손실 발생



Cu Corrosion (Loss)



Defect/Particle Growth

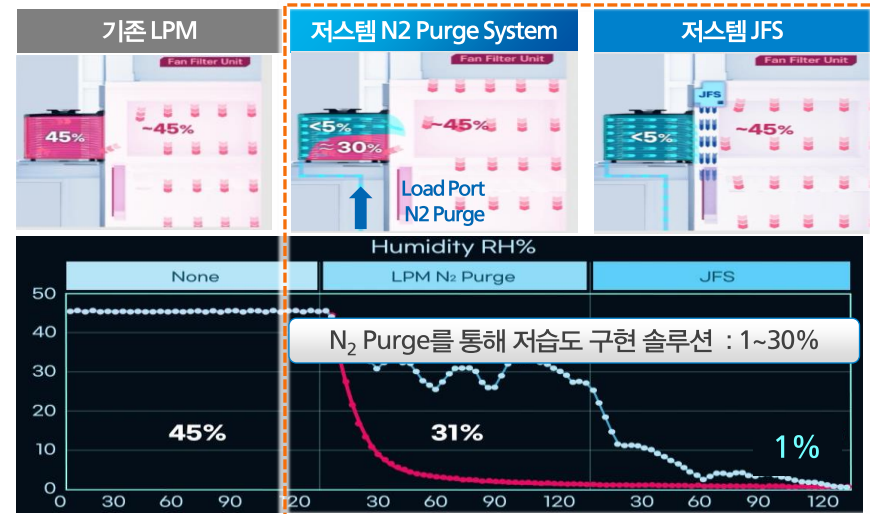
수율 개선 관련 기술적 한계 봉착

## 저스템 저습도 관리 솔루션

## N2 Purge System란?

반도체 웨이퍼 이송 및 보관을 위한 LPM에 핵심 기술인 노즐을 장착 및 개조 후 N2(질소)를 주입하여 웨이퍼 습도 제어 및 불순물 제거하는 시스템

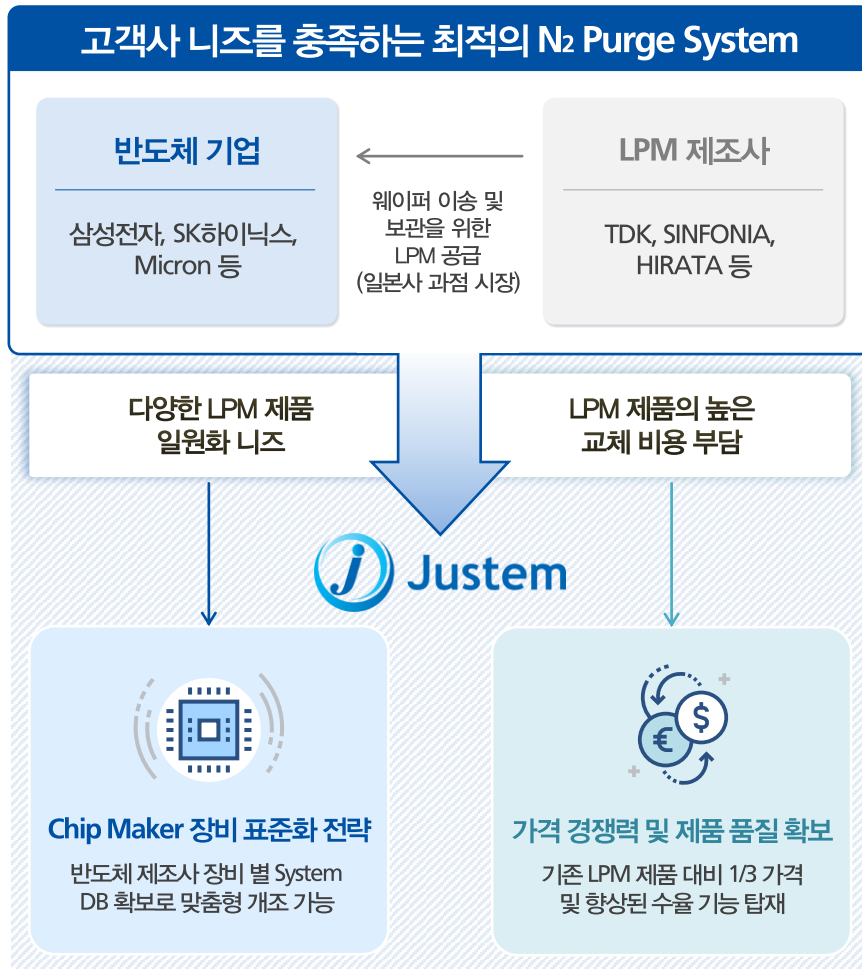
FOUP 내부 환경 제어를 통해 웨이퍼 품질 및 신뢰성 상승



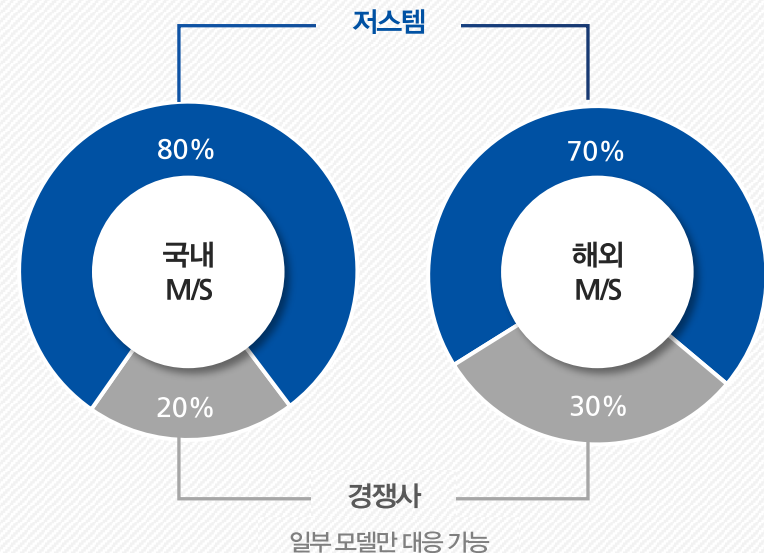
수율 제어를 통한 초미세화 공정 수율 증대  
IDM 3사 표준화 적용  
(Fab 당 1,500억 원 절감 효과)

## 반도체 시장 내 수율 개선 핵심 플레이어, 저스텀 (2)

효율적인 수율 개선을 위한 최적의 선택지 N2 Purge System

N<sub>2</sub> Purge System의 시장지배력 구축

저스텀은 LPM 11개社 110 모델 대응 가능(90% 이상)  
**글로벌 주요 IDM 3사 M/S 85% 달성**  
 (삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)



\*2024년 시장점유율 기준

## 습도 제어 솔루션 제품 포트폴리오

다양한 고객 수요에 대응 가능한 제품 Line-up 구축

## N2 Purge System 제품 소개

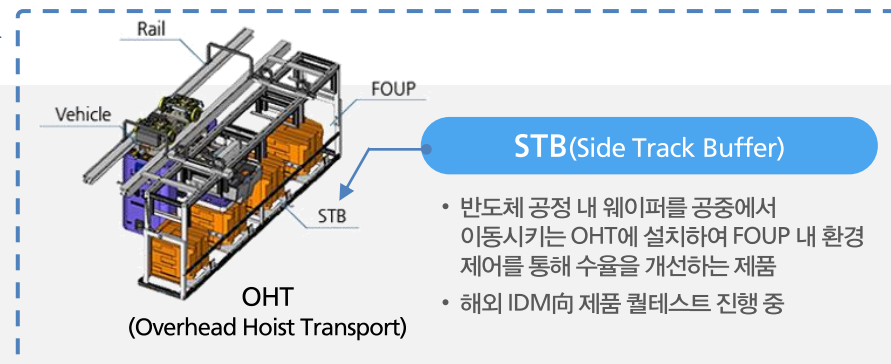
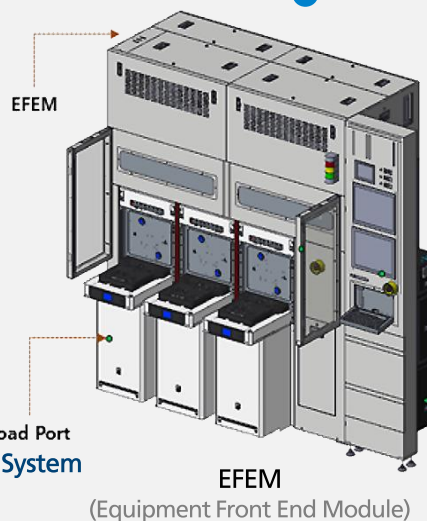
## N2 Purge LPM

- 반도체 공정 내 매엽식 장비에 장착되는 LPM(Load Port Module)\*에 부착 및 개조되어 FOUP 내 환경 제어를 통해 수율을 개선하는 제품

## BIP(Built In Purge)

- Batch 타입 반도체 증착 장비에 N2를 Purge 할 수 있는 모듈을 장착 및 개조하여 수율을 향상시키는 제품

Load Port  
LPM N2 purge System



## STB(Side Track Buffer)

- 반도체 공정 내 웨이퍼를 공중에서 이동시키는 OHT에 설치하여 FOUP 내 환경 제어를 통해 수율을 개선하는 제품
- 해외 IDM 向 제품 테스트 진행 중

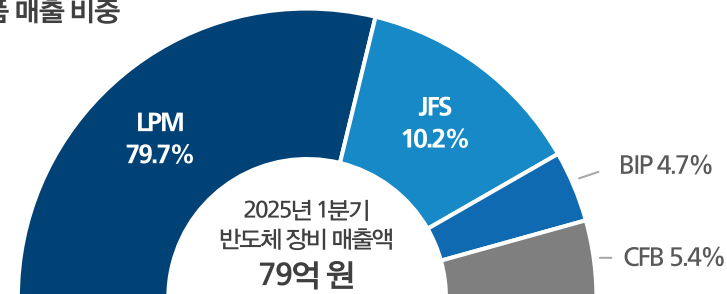
## CFB(Contamination Free Buffer)

- EFEM 좌, 우측에 설치되어 공정이 진행되어 오는 웨이퍼에 N2를 Purge 하여 수율을 향상시키는 제품
- 장비 제조사에 공급 추진 중

## 주요 고객사

N2 Purge LPM	SAMSUNG SK 하이닉스 micron
CFB	SEMES
BIP	SK 하이닉스 micron HPSP

## 주요 제품 매출 비중





## 반도체 수율 개선 시스템 고도화 (1)

지속적인 제품 고도화 → 반도체 산업 내 수율 개선 부품/장비 핵심 기업으로 성장 기대

## 저스템 3세대 JDM

## 저스템 2세대 JFS

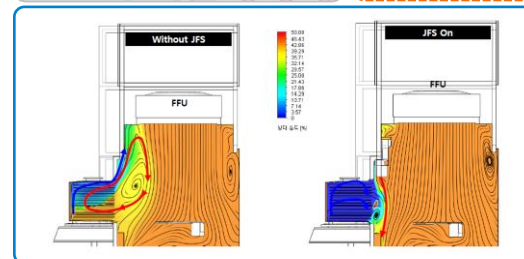
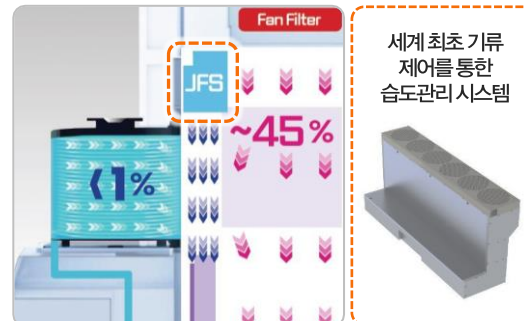
## 저스템 1세대 N2 Purge System : JLPX

[반도체 Fab 공정간 웨이퍼 이송 장비]



\*2024년 기말 기준 누적매출 2,210억 원 (수출 856억 원)

JFS (Justem Flow Straightener, Zone 습도저감모듈)



JFS : EFEM으로부터 유입되는 고습도 기류 차단으로 상시 저습도로 제어 가능

미국 M사 向 700 System 이상 판매  
국내 장비업체와 성능평가 진행 중

기존 1세대 이상의 매출 기대

JDM (Justem EFEM Dry Module for 1%, Space 습도저감모듈)

EFEM 내부 전체 습도 제어 가능한 비순환형 제습 모듈  
EFEM 내부 습도 < 5%, FOUP 내부 습도 < 1%  
소비전력 최소화, 온도제어 가능

## 기대효과

선제적 제품고도화로 시장 기술 선도



국내 EFEM 제품 비중 확대로 국산화 기여



반도체 산업 내 시장 점유율 확대

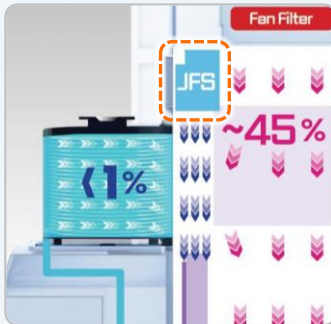
국내 장비업체와 성능평가 진행 중

## 반도체 수율 개선 시스템 고도화 (2)

세계 최초 JFS 개발을 통해 기존 시장내 점유율 증가 및 신규 고객사 확대



## 세계 최초 기류 제어 습도제어 솔루션



**JFS**  
(Justem Flow Straightener)

EFEM으로부터 유입되는 고습도 기류 차단으로 폼(FOUP) 내 습도를 상시 1%이하로 제어 가능

저습환경 제공으로  
수율 개선 효과 검증

반도체 분야 수율 제어  
표준기술 채택 기대

반도체 첨단 투자  
집중 전략 수혜

## 해외 IDM M사 向 JFS 공급

선단 공정 내 낮은 수율 문제 해결을 위한  
습도제어 솔루션 중요도 상승

2023년 공정평가 후 단기간 내 M사 주요 Fab으로 공급

- 2024.03 M사일본 Fab 공급
- 2024.03 M사대만 Fab 공급
- 2025.03 M사싱가포르 Fab 공급

**M사 向 JFS 700 System 이상 공급**  
(M사 向 매출 급증 전망)

## 글로벌 IDM 제품 상용화 계획

## 글로벌 Top3 IDM 업체 현장 평가

## A사

• JFS 공급 진행

- JFS 본격 공급
- 메모리 및 파운드리 선단 공정 向 수주 기대

## B사

• 평가진행 중

- 25년 평가 완료 목표
- 메모리 선단 공정 向 수주 기대



다양한 IDM 고객사 확보에 따른 시장 선점 기대

SAMSUNG SK 하이닉스 micron intel SMIC

## 디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축

OLED 시장의 수율개선 필요성 증대로 공정 및 설계기술 기반 시장진출

## 디스플레이 산업 동향

## 6G → 8.6G ITOLED 대형화로 신규 투자 기대

: 2stack tandem Cell등 차량 및 IT 기기향  
OLED 수요 증가로 신규 투자발생

## OLED 패널 불량관리/수율 향상 중요성 증가

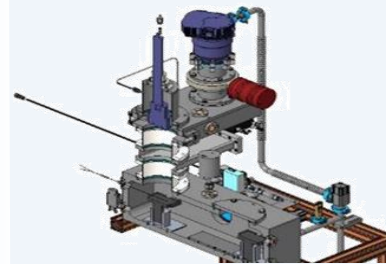
: 수율 개선을 위해 각 공정 이동 간 진공  
환경에서의 패널 이송 장비 필수요구

글로벌 디스플레이 패널 기업들의

OLED 패널 수율 향상 니즈 증가

디스플레이 수율  
극대화 장비  
Line-up 구축

## OLED 증착공정 수율 극대화 솔루션



## 대면적 OLED 제조용 고진공 장비

고진공 환경내 OLED의 소자불량을 유발하는  
정전기 제거를 위한 제전장치로 OLED 패널  
수율 향상을 위한 필수 기술

※ 장영실 상 수상

대면적 고진공  
제전 균일도 확보고객사에서  
양산 검증 완료반도체 분야 수율 제어  
기술 레퍼런스 보유

## 국내 업체 제품 상용화 계획

## 주요 디스플레이 업체 현장 평가

## A사

- 양산평가 진행 완
- 대형 패널용 장치 평가중

- 23년 10월 중소형 OLED 라인 도입
- 25년 대형 Panel 라인 적용

## B사

- 양산평가 진행 중

- 25년 평가 완료 목표
- 25년 순차 적용

## 해외 업체 제품 상용화 계획

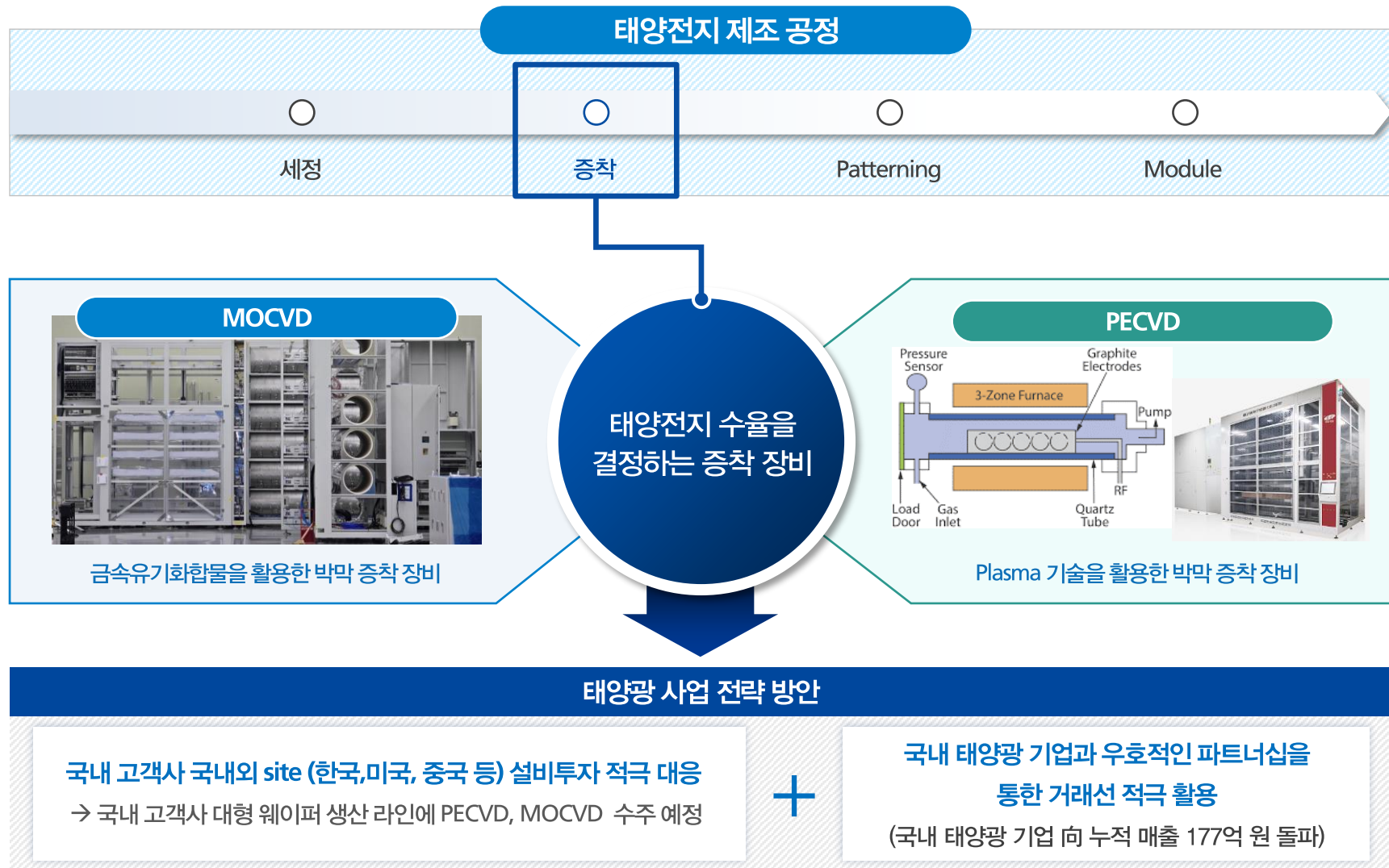
주요 디스플레이 업체  
현장 평가 진행 중

중화권 지역 타깃 고객사



## 태양광 산업 진출 본격화

신규 기술 기반 태양광 산업으로 매출확대 본격화



# CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



## 01

Investor Relations 2025

### Company Overview

- 01. 회사개요
- 02. 원천기술기반 성장스토리
- 03. 연구 개발 역량
- 04. 주요 생산 인프라
- 05. 기술 로드맵
- 06. 사업 영역



## 회사개요

글로벌 첨단산업 수율개선 핵심 기업, 저스템



## 회사개요

회사명	주식회사 저스템
대표이사	임영진
업종	반도체, 디스플레이 부품 제조 및 생산
설립일	2016년 4월 25일
자본금	3,631백만 원
종업원	135명('25년 09월 現)
본사 및 공장	경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57 2공장: 경기도 화성시 동탄산단 10길 42
주요 고객	삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 한화, LG 전자
영업 Agency	중국, 대만, 싱가포르, 일본, 미국

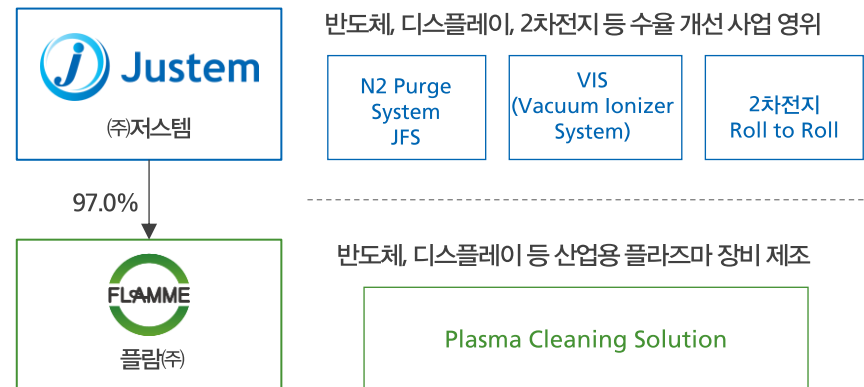
## 대표이사 소개



## 임영진 대표이사 (금속공학 박사)

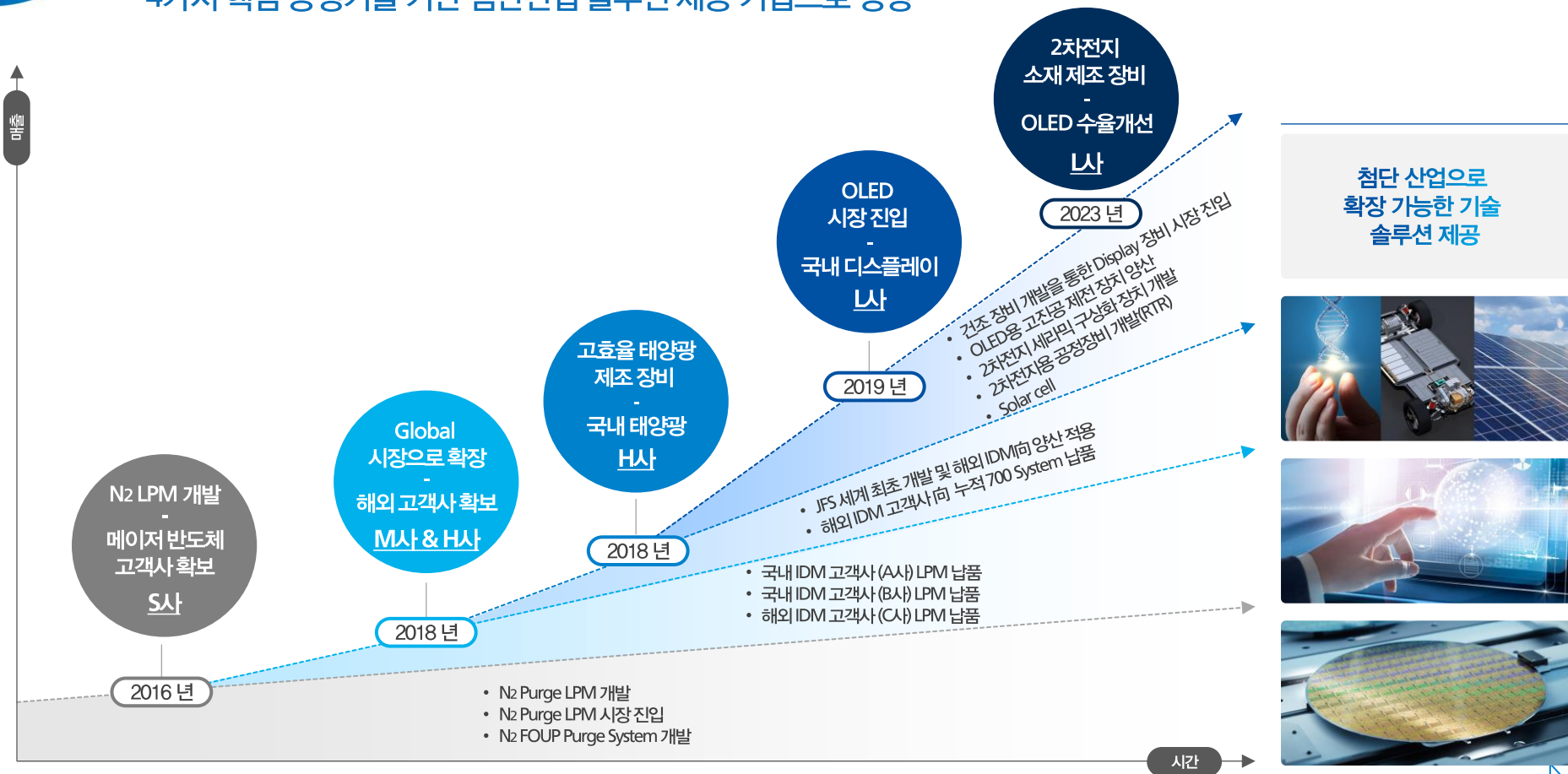
- 2009. 지식경제부/한국산업기술진흥원 국무총리상 수상
- 2019. 무역의 날 대통령 표창수상
- 2020. 상공의 날 산업통상부 장관 표창수상
- 2024. 납세자의 날 중부지방국세청장표창수상

## 지배구조 및 사업영역



## 원천기술기반 성장스토리

4가지 핵심 공정기술 기반 첨단산업 솔루션 제공 기업으로 성장



## 4가지 핵심 공정

저스템의 핵심 공정  
융합 기술N2 치환 및 기류제어를  
통한 습도관리

진공 대응 기술

플라즈마, 열 응용기술

자동화 구성,  
Sequence 최적화 기술

+ 첨단 산업 설계 기술

## 연구개발 역량

첨단산업 수율개선 글로벌 핵심 기업으로 성장하는 K-HERO 저스템

## ● 업계 최고 수준 R&amp;D 경쟁력

## 최우수 기업연구소 선정



세계 최고 수준의 기업연구소로  
성장할 잠재력을 가진 연구소 선정  
(중소기업 유일 선발)

## 장영실상 수상



대한민국 정부가 인정하는  
최고의 신기술 제품 혁신 상  
(OLED용 고진공 이온화 제전장치)

차별화된 연구개발 역량을 통한 업계 최고 수준의 기술력 인증

## 주요 인증 현황



## ● 특허 현황



기술 특허 확보  
진입장벽 구축

특허 수 334건

등록 수 139건

출원 195건

해외 36건

## 주요 생산 인프라

반도체 클러스터와 근거리에 위치한 첨단산업 제조 특화 생산 인프라 구축

저스템  
본사

**위치** 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57  
**면적** 4,012m<sup>2</sup>  
**생산 제품** 반도체 N2 Purge System, JFS, JDM

## 2사옥

**위치** 경기도 화성시 동탄산단 10길 42  
**면적** 5,544m<sup>2</sup>  
**생산 제품** 2차전지 장비, 디스플레이 장비, 태양광 장비



## 반도체, 디스플레이 장비 제조 주력 사업장



반도체 생산 Fab



디스플레이 생산 Fab



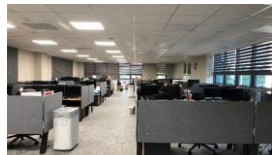
## 디스플레이, 2차전지 장비 제조 주력 사업장



2차전지, 디스플레이 생산 Fab



플라즈마 장비 개발 Fab



기술연구소



핵심기술(진공, 습도제어, S/W, 열, 대면적 기술) 확보를 통한 수평적, 수직적 제품 Portfolio 확대 가능





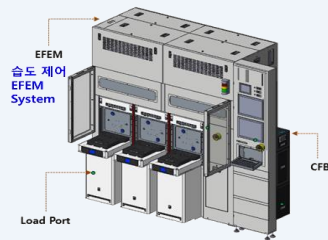
## 사업 영역



기술 경쟁력을 통해 반도체 / 디스플레이 / 태양광 / 2차전지 산업 내 다양한 사업 포트폴리오 구축

## 주요 사업 영역

## 반도체



## 반도체 질소 순환 (습도제어) 솔루션

- N2 Purge System (LPM, BIP, CFB, STB)
- JFS U1, U5
- EFEM Dry Module
- HBM Hybrid Bonding 장비

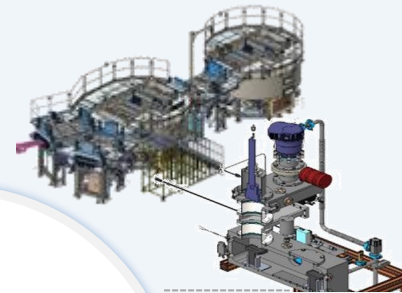
SAMSUNG



micron



## 디스플레이



## 대면적 OLED 제조용 장비

- 10.5G OLED 用 HVCD 장비
- OLED용 진공 Transfer 장비
- OLED용 N2 Transfer 장비
- N2 Purifier (급속 치환 장치)
- Laser Patterning 장비
- Micro LED Repair

## OLED 고잔공 제전장치 VIS

SAMSUNG DISPLAY

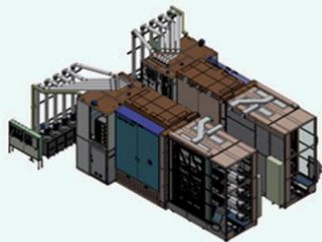


Visionox



Justem

## 주요 제품 Line-up



## 태양광 증착용 PECVD

- PECVD
- RPCVD
- POCL

## Plasma cleaning



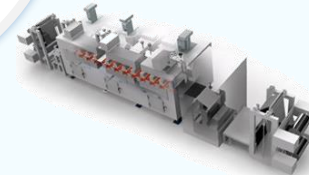
## 태양광

## 2차전지 롤투롤 장비

- 전극 건조 장비

## 2차전지 열처리 장비

- 음극재 및 분리막용 세라믹 소성 소재
- 반도체 코팅 및 방열 소재



Japan Company(N社)



## 2차전지

— Thank you —

주주와 함께 성장하는  
저시스템이 되겠습니다.



The background of the image is a photograph of a data center aisle, showing rows of white server racks and complex cable management systems on the ceiling. The image is overlaid with a dark blue gradient and numerous out-of-focus blue and white light spots, creating a bokeh effect. The text 'Q&A' is centered in the middle of the image.

# Q&A



# CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



Investor Relations 2025

## Appendix

01. 요약 재무제표

## 재무상태표

단위 : 백만 원

구분	2023	2024	2025.3Q
유동자산	26,574	24,451	24,699
비유동자산	54,465	53,918	58,689
자산총계	81,039	78,369	83,388
유동부채	8,450	28,428	29,430
비유동부채	23,923	1,494	795
부채총계	32,373	29,922	30,225
자본금	3,579	3,625	3,631
자본잉여금	20,584	21,222	21,349
기타자본	895	2,239	2,661
이익잉여금	23,607	21,361	25,521
자본총계	48,666	48,446	53,163

주: KIFRS 별도 재무제표 기준

## 손익계산서

단위 : 백만 원

구분	2023	2024	2025.3Q
매출액	34,825	37,787	33,239
매출원가	19,979	24,540	17,886
매출총이익	14,845	13,246	15,353
판매비	14,472	17,237	10,932
영업이익	373	-3,991	4,421
금융손익	-2,354	1,987	20
기타손익	-2,732	-1,132	-261
법인세비용차감전순이익	-4,712	-3,136	4,180
법인세비용	-1,337	-1,155	0
당기순이익	-3,375	-1,980	4,180

주: KIFRS 별도 재무제표 기준